

特点:

- 输出功率典型值: +2dBm
- SMT 封装
- 封装尺寸: 14.2*14.2*3.7(MAX)mm
- 工作温度: -55~+85°C
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (TA=25°C)

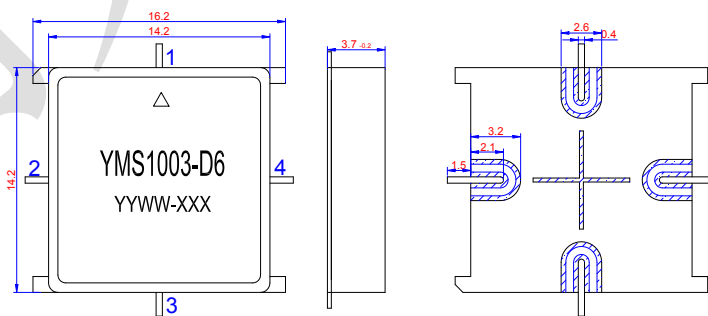
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
输出频率	F _{OUT}	工作电压: 5V 参考频率: 64MHz 参考功率: 3~8dBm 参考相噪: ≤ -150dBc/Hz@1K	127.99	128	128.01	MHz	
输出功率	P _{OUT}		2			dBm	
二次谐波抑制					-12	dBc	
杂散抑制					-70	dBc	
相位噪声	PN				-110	dBc/Hz	@1K
					-115	dBc/Hz	@10K
					-115	dBc/Hz	@100K
					-125	dBc/Hz	@100K
锁定指示	锁定			+3	+3.4	V	
	失锁			0	+0.4	V	
电源电压	V _{CC}		+4.8	+5	+5.2	V	
电源电流	I _{CC}				230	mA	
质量	m				10	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压 V _S	+5.5	V	静电防护等级(HBM)	Class 1A	/
贮存温度	-55~+100	°C			

封装外形图:

单位: mm



注: 1、外形公差±0.2mm, 其余未标注公差按 GB/T1804-2000 规定, 公差等级 f;

2、产品本体采用氧化铝陶瓷金属封装, 引脚及底部焊盘表面镀镍金 (Ni 1.2~8.9um, Au 1.2~5.7um);

3、产品标识采用激光刻字, 完成后盖板和底座进行平行缝焊处理。

字符标志：

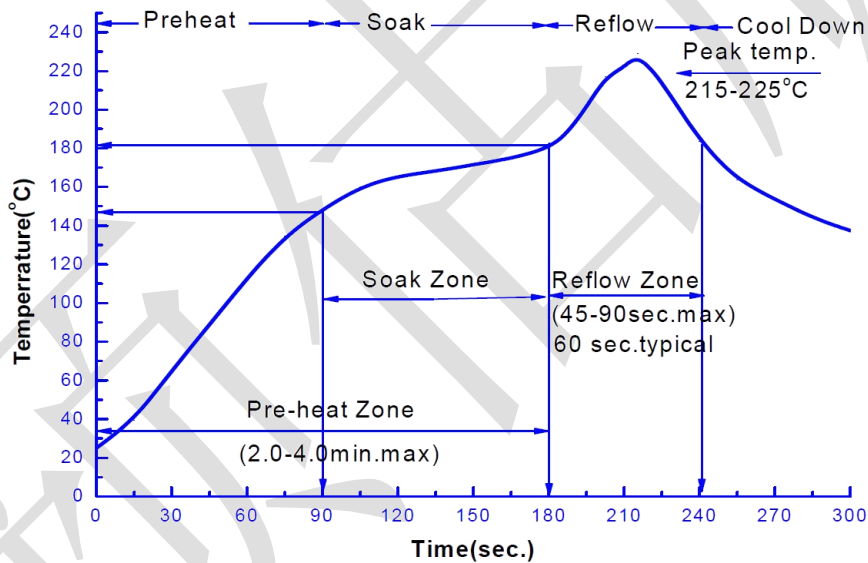
YMS1003-D6	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

引脚	符号	定义
1	Vcc	电源
2	REF	参考
3	LD	锁定指示
4	RF OUT	射频输出端

产品使用注意事项：

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品在运输、装配使用过程中请注意对产品引脚的防护，防止引脚受外界应力变形及引脚根部开裂；
- 4.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 5.如特殊情况需采用手工焊接，应进行预热处理，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
- 6.产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 7.客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。